

# 日本国特許庁 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年 9月30日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第279870号

株式会社半導体エネルギー研究所

2000年 6月29日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆彦

【書類名】

特許願

【整理番号】

P004372-03

【提出日】

平成11年 9月30日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01L 21/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

山崎 舜平

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

荒井 康行

【特許出願人】

【識別番号】

000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】

山崎 舜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機EL表示装置

【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

単結晶半導体基板に形成した絶縁ゲート型電界効果トランジスタ上に有機EL 層が形成されたアクティブマトリクス型の有機EL表示装置において、

前記有機EL表示装置は、絶縁材料で形成された台板と蓋板とを接着する充填 材とで形成された空隙の中に前記単結晶半導体基板が保持され、

前記空隙には不活性ガスと乾燥剤が封入されていることを特徴とする有機EL表示装置。

## 【請求項2】

単結晶半導体基板に形成した絶縁ゲート型電界効果トランジスタ上に有機EL層が形成された画素部を有するアクティブマトリクス型の有機EL表示装置において、

前記有機EL表示装置は、絶縁材料で形成された台板と蓋板とを接着する充填 材とで形成された空隙の中に前記単結晶半導体基板が保持され、

前記蓋板は、前記画素部と重なる領域において、透光性の部材で形成され、

前記空隙には不活性ガスと乾燥剤が封入されていることを特徴とする有機EL表示装置。

#### 【請求項3】

単結晶シリコン基板に形成した絶縁ゲート型電界効果トランジスタ上に有機E L層が形成された画素部を有するアクティブマトリクス型の有機EL表示装置に おいて、

前記有機EL表示装置は、セラミック材料で形成された台板と蓋板とを接着する充填材とで形成された空隙の中に前記単結晶シリコン基板が保持され、

前記蓋板は、前記画素部と重なる領域において、透光性の部材で形成され、

前記空隙にはヘリウム、アルゴン、クリプトン、キセノン、窒素から選ばれた 不活性ガスと、酸化バリウム、シリカゲルから選ばれた乾燥剤が封入されている ことを特徴とする有機EL表示装置。

## 【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の有機EL表示装置をゴーグル型 表示装置の表示部に用いたことを特徴とする有機EL表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は単結晶半導体を活性層とした絶縁ゲート型電界効果トランジスタによる回路を有する半導体装置およびその作製方法に関する。特に本発明は、画素部と、その周辺に設けられた駆動回路を同一基板上に設けた有機エレクトロルミネッセンス表示装置に代表される電気光学装置、および電気光学装置を搭載した電子機器に好適に利用することができる。尚、本願明細書において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能する装置全般を指し、上記電気光学装置およびその電気光学装置を搭載した電子機器をその範疇に含んでいる。

[0002]

## 【従来の技術】

液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス(E L: Electro Luminescence)表示装置などに代表される平板型表示装置(フラットパネルディスプレイ)において、単結晶半導体基板に形成した絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(以降、電界効果トランジスタをFETと記す)を用いてアクティブマトリクス型表示装置を作製する技術が知られている。これはガラス基板や石英基板上に薄膜トランジスタ(以降、TFTと記す)を形成してアクティブマトリクス型表示装置を作製する場合と異なり、大規模集積回路(LSI)で培われた技術をそのまま応用することが可能であり、高速で低電圧駆動が可能な高性能のFETを基板上に高密度に集積形成できることに利点があった。しかし、その一方で基板が可視光に対して不透明であるため反射型、或いは自発光型の表示装置に限定される点や、単結晶半導体基板が市場で供給されるサイズに限定されるといったことが欠点と考えられていた。

[0003]

しかしながら、表示装置の分野における高画質化やフルデジタル化といった技

術指向のにおいて、アクティブマトリクス型表示装置に要求される性能向上は必然的に高まってきている。アクティブマトリクス型表示装置において画像表示を行う画素部には、数十から数百万個のトランジスタ(TFTやFETなど)が配置されていて、そのトランジスタのそれぞれに画素電極が接続される構成となっている。そして、各画素に印加する電圧をトランジスタのスイッチング機能により制御して、EL素子を発光させて画像を表示する仕組みになっている。有機EL表示装置においては、それぞれの画素に設けられたスイッチ用トランジスタがオンになると、画像データに応じた信号により電流制御用トランジスタに電流が流れ、EL素子が自発光する仕組みになっている。

[0004]

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、有機EL表示装置の基本部分となる有機EL層は極めて酸化に弱く、僅かな酸素の存在により容易に劣化してしまう。また、熱にも弱く、これもまた酸化を助長する原因となる。この酸化に弱いという欠点が有機EL素子の寿命の短さの原因であり、実用化する上で大きな障害となっていた。

[0005]

本発明はこのような問題点を克服し、信頼性の高い有機EL表示装置を提供することを課題とする。そして、そのような有機EL表示装置を表示部として用いることにより表示部の信頼性が高い電子装置を提供することを目的とする。

[0006]

#### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明の構成は、単結晶半導体基板に形成した絶縁 ゲート型電界効果トランジスタ上に有機EL層が形成されたアクティブマトリク ス型の有機EL表示装置において、前記有機EL表示装置は、絶縁材料で形成さ れた台板と蓋板とを接着する充填材とで形成された空隙の中に前記単結晶半導体 基板が保持され、前記空隙には不活性ガスと乾燥剤が封入されていることを特徴 としている。

[0007]

また、他の発明の構成は、単結晶半導体基板に形成した絶縁ゲート型電界効果

トランジスタ上に有機EL層が形成された画素部を有するアクティブマトリクス型の有機EL表示装置において、前記有機EL表示装置は、絶縁材料で形成された台板と蓋板とを接着する充填材とで形成された空隙の中に前記単結晶半導体基板が保持され、前記蓋板は、前記画素部と重なる領域において、透光性の部材で形成され、前記空隙には不活性ガスと乾燥剤が封入されていることを特徴としている。

## [0008]

前記単結晶半導体基板としては、単結晶シリコン基板を好適に用いることができる。また、前記空隙にはヘリウム、アルゴン、クリプトン、キセノン、窒素から選ばれた不活性ガスと、酸化バリウム、シリカゲルから選ばれた乾燥剤が封入すると好ましい。

## [0009]

## 【発明の実施の形態】

まず、図1を参照して本発明の有機EL表示装置を説明する。本発明に係わる 有機EL表示装置は単結晶半導体基板(例えば、単結晶シリコン基板)上に形成 した絶縁ゲート型の電界効果トランジスタ(FET)により、画素部およびその 周辺に駆動回路を設けた構造である。

## [0010]

基板101は比較的高抵抗(例えば、n型、10Ωcm程度)の単結晶シリコンから成り、pウエル102、nウエル103~105が自己整合的に形成されている。隣接するFETはフィールド酸化膜106で分離されている。フィールド酸化膜106の形成に当たっては、ボロン(B)を選択的にイオン注入法により基板に導入し、チャネルストッパーを形成しても良い。

## [0011]

ン層は低抵抗化するために予め $10^{21}$ /  $cm^3$ 程度の濃度でリン(P)をドープしておいても良いし、多結晶シリコン膜を形成した後で濃いn型不純物を拡散させても良い。シリサイド層の材料はモリブデンシリサイド(MoSix)、タングステンシリサイド(WSix)、タンタルシリサイド(TaSix)、チタンシリサイド(TiSix)などを適用することが可能であり、公知の方法に従い形成すれば良い。

#### [0012]

pチャネル型FET201の低濃度ドレイン(LDD)領域107にはp型の 導電型を付与する不純物元素としてボロン(B)がドーズ量で $1\times10^{13}\sim1\times10^{14}/c$  m<sup>2</sup>添加されている。一方、nチャネル型FET202とnチャネル型FETで作製されるスイッチングFET203、電流制御FET204のLDD領域113、119、125にはn型の導電型を付与する不純物元素としてリン(P)または砒素(As)がやはり同様のドーズ量で添加されている。これらのLDD領域はゲートをマスクとしてイオン注入法またはイオンドープ法で自己整合的に形成されている。

#### [0013]

#### [0014]

第1の層間絶縁膜131は好適にはプラズマCVD法や減圧CVD法で作製さ

れる酸化シリコン膜や酸化窒化シリコン膜などで $100\sim2000$  n mの厚さ形成する。さらにその上にリンガラス(PSG)、あるいはボロンガラス(BSG)、もしくはリンボロンガラス(PBSG)の第2の層間絶縁膜132が形成されている。第2の層間絶縁膜132はスピンコート法や常圧CVD法で作製されるもので、形成後実施される $700\sim900$ での熱処理を兼ねた熱活性化の処理により第2の層間絶縁膜132がリフローされ表面が平坦化される。

#### [0015]

ソース配線133、135、137、139及びドレイン配線134、136、138、140は、第1の層間絶縁膜131および平坦化膜132にそれぞれのFETのソース領域及びドレイン領域に達するコンタクトホールを形成した後形成されるもので、低抵抗材料として通常良く用いられるアルミニウム(A1)を用いると良い。また、A1とチタン(Ti)の積層構造としても良い。

#### [0016]

パッシベーション膜141は、プラズマCVD法で窒化シリコン膜、または酸化シリコン膜、あるいは窒化酸化シリコン膜で形成されている。さらに、第3の層間絶縁膜を142は有機樹脂材料で1μm~2μmの厚さに形成されている。有機樹脂材料として、ポリイミド、ポリアミド、アクリル、ベンゾ・シクロ・ブテン(BCB)などを用いることができる。有機樹脂膜を用いることの利点は、膜の形成方法が簡単である点や、比誘電率が低いので寄生容量を低減できる点、平坦化するのに適している点などがある。勿論、上述した以外の有機樹脂膜を用いても良い。ここでは、基板に塗布した後で熱重合するタイプのポリイミドを用い、クリーンオーブンで300℃に加熱し焼成して形成している。

## [0017]

画素電極143は電流制御FET204のドレイン配線に接続している。画素電極は、A1に代表される低抵抗の材料で形成する。A1膜は公知の成膜法、例えば真空蒸着法やスパッタ法で容易に形成することができるが、コントラストを良くするために、画素電極143の表面を凹凸化して拡散反射面としても良い。

## [0018]

画素電極143まで形成したら、全ての画素電極の上に仕事関数の低い金属を

含む陰極層144が形成される。これは数nm程度と膜厚が薄いため層状に形成されているのか島状に点在しているのか不明のため、輪郭を点線で示している。

#### [0019]

上記仕事関数の低い金属を含む陰極層の材料としては、フッ化リチウム(LiF)、酸化リチウム(Li $_2$ O)、フッ化バリウム(BaF $_2$ )、酸化バリウム(BaO)、フッ化カルシウム(CaF $_2$ )、酸化カルシウム(CaO)、酸化ストロンチウム(SrO)または酸化セシウム(Cs $_2$ O)を用いることができる。これらは絶縁性であるため、層状に形成されたとしても画素電極間のショート(短絡)を招くようなことはない。勿論、MgAg電極のような公知の導電性を有する材料を陰極層として用いることも可能であるが、画素電極同士が短絡しないように、陰極自体を選択的に設けるか、パターニングを行う必要がある。

## [0020]

仕事関数の低い金属を含む陰極層144の上に有機EL層(エレクトロルミネッセンス層)145が形成される。有機EL層145は公知の材料や構造を用いることができるが本願発明では白色発光の可能な材料を用いる。構造としては、再結合の場を提供する発光層だけで有機EL層としても良いし、必要に応じて電子注入層、電子輸送層、正孔輸送層、電子阻止層、正孔素子層もしくは正孔注入層を積層しても良い。本明細書中では、キャリアの注入、輸送または再結合が行われる層をすべて含めて有機EL層と呼ぶ。

#### [0021]

また、有機EL層145として用いる有機EL材料はポリマー系の高分子系有機EL材料を用いる。有機EL層145は、PVK(ポリビニルカルバゾール)、Bu-PBD(2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4''-ビフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール)、クマリン6、DCM1(4-ジシアノメチレン-2-メチルー6-p-ジメチルアミノスチリルー4H-ピラン)、TPB(テトラフェニルブタジエン)、ナイルレッドを1,2-ジクロロメタンまたはクロロホルムに溶解し、スピンコート法により塗布する。回転数は500~1000rpm程度とし、20~60秒間回転させ均一な塗布膜を形成する。

[0022]

勿論、上記有機EL材料は少なくとも3回以上、好ましくは5回以上の精製( 典型的には透析法)を施し、含まれるナトリウム濃度を0.1ppm以下(好ま しくは0.01ppm以下)にしてから成膜する。こうすることで図4(C)に 示す有機EL層 349中に含まれるナトリウム濃度は0.1ppm以下(好まし くは0.01ppm以下)となり、体積抵抗値は $1\times10^{11}\sim1\times10^{12}\Omega$ cm( 好ましくは $1\times10^{12}\sim1\times10^{13}\Omega$ cm)となる。

#### [0023]

#### [0024]

また、陽極層146の上にはパッシベーション膜147として絶縁膜が設けられる。パッシベーション膜147としては、窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜(SiOxNyで表される)を用いることが好ましい。

### [0025]

ここまで完成した基板を本明細書ではアクティブマトリクス基板と呼ぶ。即ち TFTと該TFTに電気的に接続された画素電極及びその画素電極を陰極とする 有機EL素子(陰極層、有機EL層及び陽極からなるコンデンサ)の形成された 基板をアクティブマトリクス基板と呼ぶ。

#### [0026]

図2(A)はアクティブマトリクス基板の画素部の上面図であり、図2(B)はその回路構成である。実際には画素がマトリクス状に複数配列されて画素部(画像表示部)が形成される。なお、図2(A)をA-A'で切断した断面図が図1の画素部の断面図に相当する。従って図1及び図2で共通の符号を用いているので、適宜両図面を参照すると良い。また、図2(A)の上面図では二つの画素を図示しているが、どちらも同じ構造である。図2(B)に示すように、有機EL素子205には、一画素当たり2つのFETが設けられる。いずれもnチャネル型FETであり、スイッチング用FET203と電流制御用FET204とし

て機能している。

[0027]

以上のようにして、単結晶シリコン基板に、pチャネル型FET201とnチャネル型FET202とから成るCMOS回路を基本とする駆動回路と、nチャネル型FETで形成されるスイッチング用FET203と電流制御用FET204とを備えた画素部が形成することができる。CMOS回路を基本とする駆動回路は、CMOS回路を基本として例えば、シフトレジスタ回路、バッファ回路、サンプリング回路、D/Aコンバータ、ラッチ回路などを形成することができる。そしてこのような回路は、単結晶シリコンを活性層とした絶縁ゲート型FETで構成されることにより高速動作が可能であり、また、駆動電圧を3~5Vとして低消費電力化をすることもできる。尚、本実施形態で説明したFETの構造はあくまで一実施形態であり、図1に示した構造に限定される必要はない。

[0028]

図3はアクティブマトリクス基板の上面図である。図3において、1000は基板、1001は画素部、1003はデータ線側駆動回路、1002は走査線側駆動回路であり、それぞれの駆動回路の入力端子は基板1000の端部に設けられるワイヤボンディング用のパッド1006であり、配線1004~1005を経て接続される。画素部のサイズは0.5インチクラスから2.5インチクラス程度のものが好適に作製することができる。

[0029]

有機EL層が形成されたアクティブマトリクス基板は外部からの衝撃、埃、湿度などの雰囲気から遮断するためにパッケージに封入する。パッケージの形状や方式の一例を図4に示す。台板401はセラミックなどの絶縁材料で形成されたものであり、その上に有機EL層が形成されたアクティブマトリクス基板413が低融点ガラスまたはメタライズ層402で固定される。外部回路との接続はリードフレーム404により行うが、アクティブマトリクス基板413との接続はワイヤボンディング用のパッド411を用いて金(Au)のワイヤー412で接続している。

[0030]

アクティブマトリクス基板413はセラミックの蓋板405で封止される。セラミックの蓋板405は台板401と接着層404によって接着されている。接着層404はパイロセラムセメント、酸化ビスマス系ガラス、酸化鉛系ガラスなどが使われる。台板401と同様に、セラミックなどの絶縁材料で形成された蓋板405がアクティブマトリクス基板413の画素部にかかる領域には透明石英板もしくは透明ガラス板などによる窓材406が設けられ、接着剤407で固定されている。このようにして、有機EL層が形成されたアクティブマトリクス基板413は封入され空隙414が形成される。さらに、空隙414には不活性ガス(アルゴン、ヘリウム、クリプトン、キセノン、窒素等)を充填しておいたり、酸化バリウム等の乾燥剤を設けておくことが望ましい。これによりEL素子の水分等による劣化を抑制することが可能である。

#### [0031]

本実施形態では図示しなかったが、アクティブマトリクス基板の有機EL層で 形成した個々の画素に対応して、該有機EL層上にカラーフィルターやブラック マトリクス(遮光層)を設けることにより、カラー表示に対応することもできる 。或いは、カラーフィルターを図4で示す窓406に設けても良い。

## [0032]

以上説明したような図4に示す状態は、リードフレーム404を外部機器の端子に接続することで画像信号などが入力され画素部に画像を表示することができる。本明細書中では、リードフレームを外部回路に取り付けることで画像表示が可能な状態となる物品を有機EL表示装置と定義している。

[0033]

## [実施例]

本実施例では、アクティブマトリクス型の有機EL表示装置をゴーグル型表示装置に応用する例を示す。図5は本実施例のゴーグル型表示装置の概略図を示す。ゴーグル型表示装置本体3600には左右2つの表示部が設けられ、有機EL表示装置3602R、3602L、回路基板3603R、3603L、レンズ3601R、3601Lから構成されている。

[0034]

図6(A)は図5におけるA部の断面図を示す。図6(A)、(B)に示すように、本実施例においては、ゴーグル型表示装置3600の内部のレンズ3601Rに有機EL表示装置3602Rが、信号制御回路等が形成されている回路基板3603Rにリードフレーム3606Rで接続されている。有機EL表示装置3602Rから発光する光は図中で示す矢印の光路を経て、使用者の眼球3604Rに届くことにより画像を認識させることができる。

## [0035]

有機EL表示装置は自発光のため、視野角が広くゴーグル型表示装置に応用した場合、有機EL表示装置と観察者の目の位置にずれが生じても画像の視認性は損なわれないという特徴を有している。

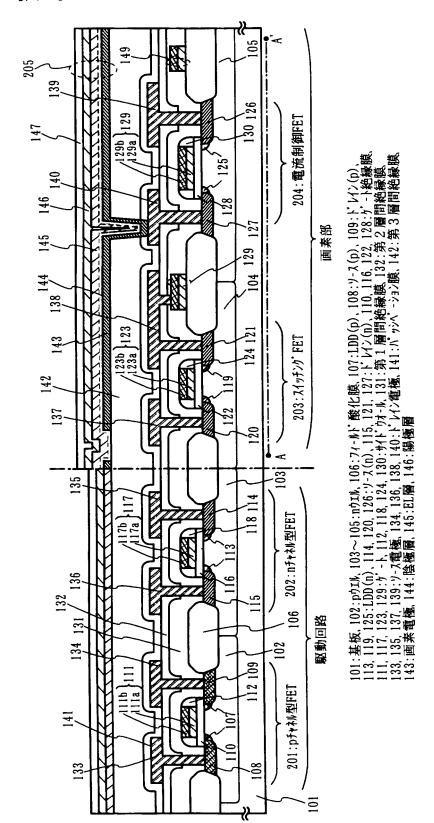
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 アクティブマトリクス型の有機EL表示装置の断面図。
- 【図2】 有機EL表示装置の画素部の上面構造及びその構成を示す図。
- 【図3】 アクティブマトリクス型の有機EL表示装置の上面図。
- 【図4】 有機EL表示装置の外観を示す図。
- 【図5】 有機EL表示装置を搭載したゴーグル型表示装置の構成を示す図。
- 【図6】 有機EL表示装置を搭載したゴーグル型表示装置の断面図。

【書類名】

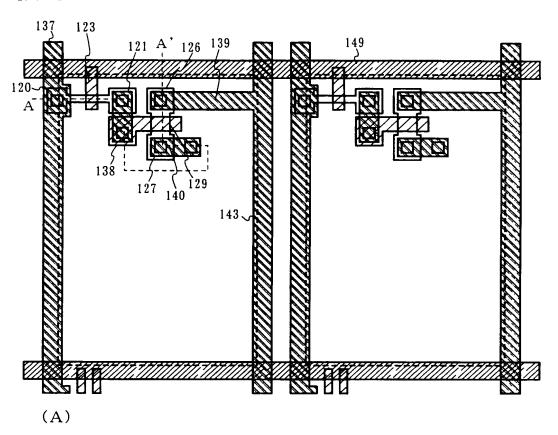
図面

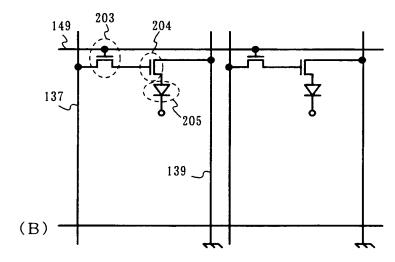
【図1】



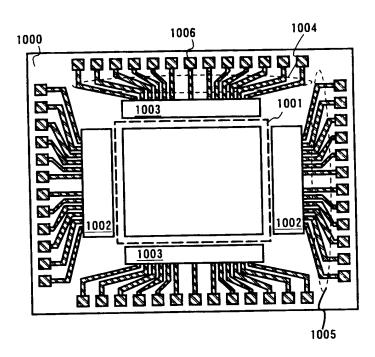
出証特2000-3051212

【図2】

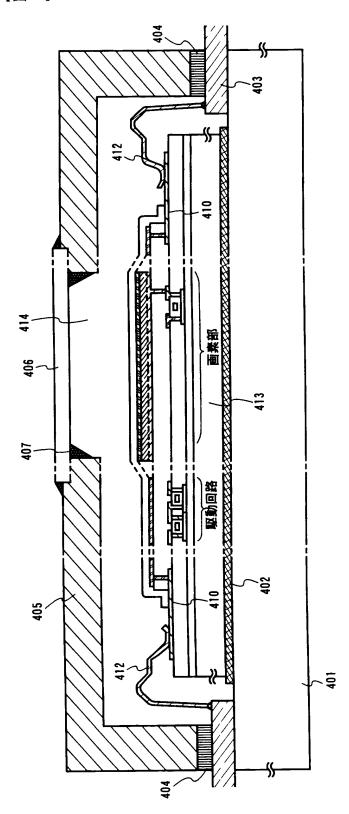




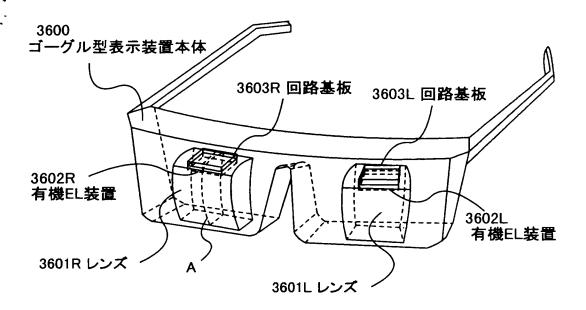
【図3】



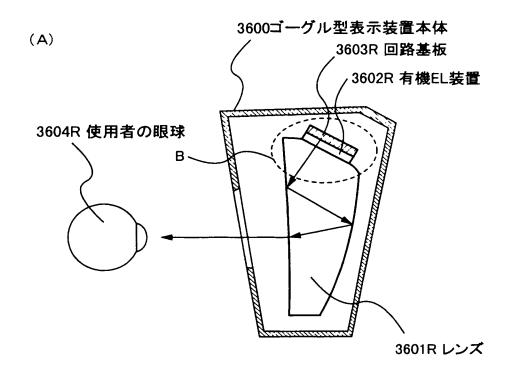
【図4】

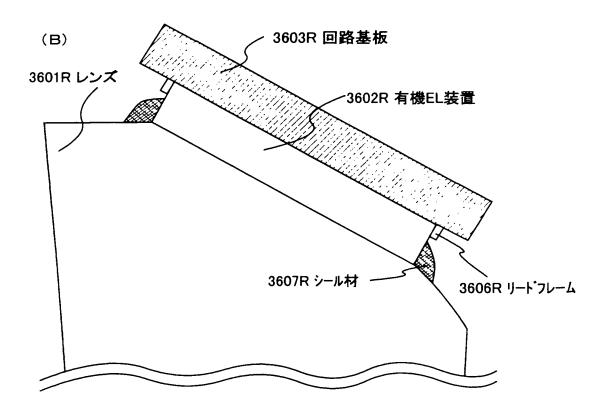


# 【図5】



【図6】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 有機EL表示装置の基本部分となる有機EL層は極めて酸化に弱く、 僅かな酸素の存在により容易に劣化してしまう。また、熱にも弱く、これもまた 酸化を助長する原因となる。この酸化に弱いという欠点が有機EL素子の寿命の 短さの原因であり、実用化する上で大きな障害となっていた。

【解決手段】 上記課題を解決するために本発明の構成は、単結晶半導体基板に 形成した絶縁ゲート型電界効果トランジスタ上に有機EL層が形成されたアクティブマトリクス型の有機EL表示装置において、前記有機EL表示装置は、絶縁 材料で形成された台板と蓋板とを接着する充填材とで形成された空隙の中に前記 単結晶半導体基板が保持され、前記空隙には不活性ガスと乾燥剤が封入されていることを特徴としている。

【選択図】 図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県厚木市長谷398番地

氏 名 株式会社半導体エネルギー研究所